

VERSION B

1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2  Verwendung fuer Leiterplattendicke: 1.6 ±0.14mm
USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ±0.14mm

3 -

4 Loetbarkeit nach DIN 40046
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046

6 Zustand vor dem Einpressen
STATUS BEFORE INSERTION

7 Zulaessige Saebelfoermigkeit: 40mm/m
PERMITTED SABERSHARPNESS: 40mm/m

Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte
Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle 1
PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS ON PCB HOLE. SEE TABLE 1

Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf Einweg Kunststoff-Spule Ø 588mm
mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton
PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON ONE-WAY PLASTIC REEL DIA.588MM
WITH INTERLEAVING PAPER, 3 REELS IN BOX.

10) Lochaufbau (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE 1)

Lochaufbau (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE 1)

Lochaufbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE 1)

13. Verdrehung Action Pin Spitze max. 30 °
DISTORTION OF ACTION PIN TIP MAX. 30 DEG.

Material spezifiziert nach UNS C19002
MATERIAL SPECIFIED ACCORDING TO UNS C19002

 Spulen mit Kunststoff-Spule PN 1-1498100-8 mit
Zwischentagenpapier PN 1-740973-2, Transportkarton 973051-2
REELED ONTO PLASTIC REEL PN 1-1498100-8 WITH INTERLEAVING
PAPER PN 1-740973-2, SHIPPING CARTON 973051-2

16 REELED ONTO REEL PN 725654-9 WITH
INTERLEAVING PAPER PN 740973-3. SHIPPING
CARTON 973051-2
Spulen mit Spule PN 725654-9 mit
Zwischenlagenpapier PN 704973-3. Transportkarton 973051-2

1.3 μm TO 2.5 μm NICKEL UPON PLATING AFTER FORMING SEQUENCE
1.3 μm bis 2.5 μm Nickel nach Formgebung ueber alles

Lochaufbau in der Leiterplatte

Tabelle 2
TABLE 2

Oberflaeche/SURFACE

Zone "I" AREA	GOLD VERSION:	0.8 μ m TO 2 μ m Au OVER Ni
	Zinn-Ausfuehrung:	1 μ m bis 3 μ m Sn
	TIN-VERSION:	1 μ m TO 3 μ m Sn
	SILVER-VERSION	1.5 μ m to 5 μ m Ag over Ni

Zone "II" AREA	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni FOR PN 8-963964-8 regarding note 
Zone "III" AREA	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

THE PN 8-963964-8 is in development status
The 8-963964-8 is not released for serial production

PN 8-963964-8 ist in dem Entwicklungsstand.
Part number 8-963964-8 ist nicht freigegeben für serieproduction

Tabelle 3
TABLE 34805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9